

High Tech Summit 2025



날짜 2025. 06. 17 화요일

장소 aT센터 3층-5층(서울 서초구 강남대로 27)

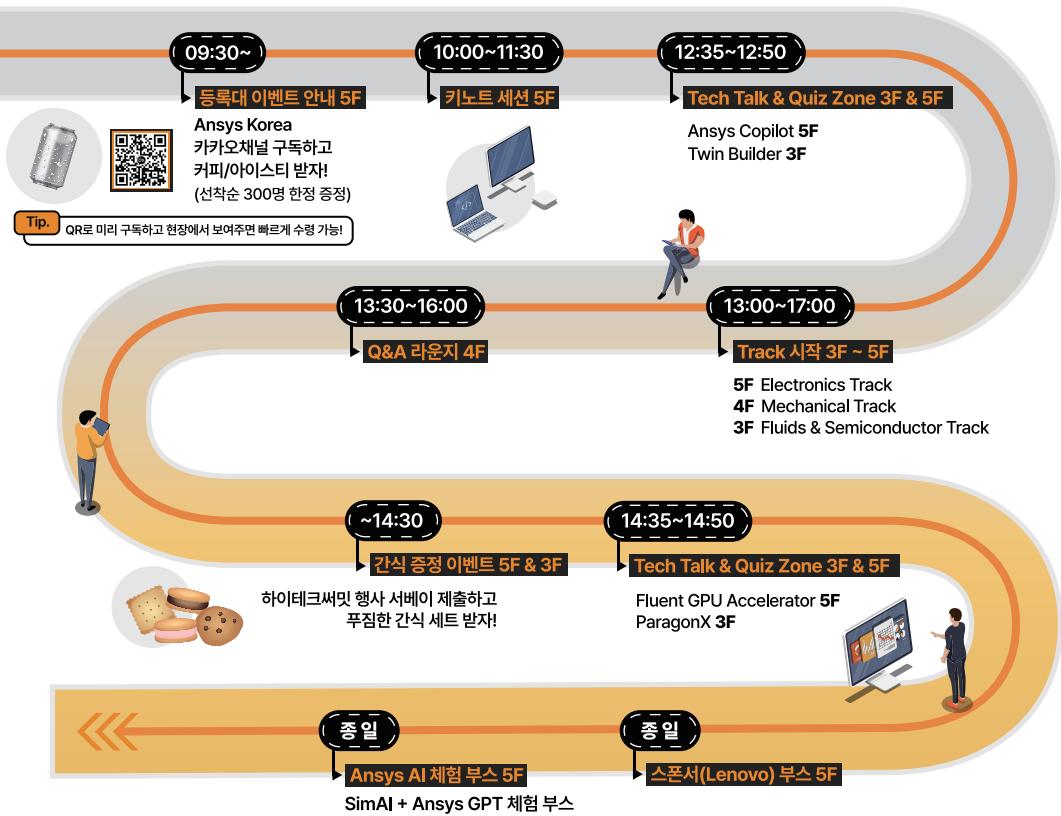
Ansys

Ansys High Tech Summit 2025

Agenda

Start	End	Keynote			
		환영사 - 박주일 대표, Ansys Korea			
10:00	10:20			메모리 반도체 분야 TCAD 활용 및 전망 - 오동연 부사장, SK hynix	
10:20	10:50				
10:50	11:10	Multiphysics Challenges in Silicon to Systems Era - Jayraj Nair Field CTO for Hi-Tech and APAC, Ansys			
11:10	11:30	The Latest Technology and Offerings from Ansys - 강태신 전무, Ansys Korea			
		Track 1 Electronics	Track 2 Mechanical	Track 3 Fluids	Track 4 Semiconductor
13:00	13:30	Ansys Electronics 2025R1 Update 김운호 매니저	Ansys Mechanical 2025R1 Update 김병길 매니저	Ansys Fluent 2025R1 Update 류연숙 프로	Ansys Semiconductor Product 2025R1 Update 최희성 매니저
13:30	14:00	Streamlining Product Design-to-Test Workflow with HFSS Layout Component and Mesh Fusion: Accurate and Efficient Full-Scale SiP Chip-on-Board Simulation Fully Incorporating Realistic Test Environments 정진우 프로	다양한 Scenario를 고려한 Free-Drop 해석 Solution 김대호 프로	Efficient Multiphase Flow Simulation via Model Transition 고승빈 프로	Introducing ParagonX and 025R1 Update 안가람 프로
14:00	14:30	Development and Validation of Thermal Resistance Matrix Evaluation Process and RL-based PI/TI Integration for Thermal-Aware SoC Floorplan Design Optimization 이명훈 프로	PolymerFEM을 이용한 재료보정 Solution 및 적용 사례 소개 김형욱 프로	Introduction to Multiphase Modeling and Boiling Model for Immersion Cooling 이정원 매니저	RHSC Advanced Feature Update 정진세 매니저
14:30	15:00	Break			
15:00	15:30	Inverse Design for Photonic IC Components 신동섭 프로	Ansys Motion & Ansys Twin Builder를 활용한 생산설비 시스템 설계 양경모 프로	Next Generation Geometry - Discovery 김영창 프로	Samsung Memory 2.5D/3D IC STCO Strategy and ECO Building Perspectives 주건 TL, 삼성전자
15:30	16:00	AI Driven Routing Project - Metamodel에 기반한 최적의 PCB/PKG 배선 김태진 프로	Time Transient 기반의 펌프 및 압축기 시스템 비선형 NVH 해석 송경훈 매니저	Electronics Cooling Solutions with Ansys Thermal Desktop - Immersion Cooling, Loop Heat Pipes, and Battery Thermal Analysis 이정훈 프로	Machine-Learning-Driven Optimization of Vertical Fiber-to-Chip Coupling System for Co-Packaged Optics and In-Package Optical I/O Applications 손정우 프로
16:00	16:30	Advanced Solutions for 5G Communication and Beyond 공기현 매니저	Dynamic 해석을 위한 접촉과 마찰의 이해 송진식 프로	AI/ML 기반 바람 조건을 고려한 무인 항공 시스템(UAS)의 공중 회랑 계획 및 동적 경로 최적화 김영호 프로	High Capacity Totem-SC for HBM Power Integrity 정민재 매니저
16:30	17:00	Ansys Maxwell E-CAD Integration 박수현 프로	Motion & LS Dyna BEM 1 Way Co-Sim 을 활용한 진동 소음 해석 성슬기 프로	Ansys Fluids Product Roadmap 전상태 프로	RedHawk-SC Electrothermal for Thermal/Structural Stress Analysis in 2.5D/3D ICs 정기욱 프로

행사 참석 가이드



행사 층별 안내도

5F



4F



3F



오늘 꼭 알아야 할 포인트!

- **점심 식사** : 지하 1층 루치아홀에서 등록 시 받은 중식 쿠폰을 제시해 주세요.

- **Tech Talk & Quiz Zone**

진행 방법 : 3층 & 5층 로비에서 진행됩니다. 브레이크 시간 동안 약 15분간 짧은 퀴즈 이벤트가 열리며, 참여하시면 소정의 선물을 드립니다.

시간표

- 1 Ansys Copilot (5층) 12:35 ~ 12:50
- 2 Twin Builder (3층) 12:35 ~ 12:50
- 3 Fluent GPU Accelerator (5층) 14:35 ~ 14:50
- 4 ParagonX (3층) 14:35 ~ 14:50

별도의 사전 등록 없이 현장에서 바로 참여하실 수 있습니다!

- **Q&A Lounge**

발표 중 궁금한 내용이 있다면?!

해당 발표 종료 후, 30분간 Q&A Lounge에서 Ansys 발표자가 여러분을 기다립니다!

- **Ansys AI 체험 부스**

Ansys GPT & Ansys SimAI를 직접 만나볼 수 있는 공간

 Ansys Korea 

카카오채널 구독하고
커피/아이스티 한잔~

오전 9시 30분부터
5층 로비에서 진행됩니다.



서베이 제출하고
푸짐한 간식 세트 받자!

오후 2시 30분에 알림톡 또는
문자로 설문 링크가 발송될 예정입니다.
3층과 5층에 마련된 부스에서
제출 완료 화면을 보여주시면,
간식 세트를 드립니다.